

公司概況資料表

以下資料由新特系統股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：新特系統股份有限公司 (股票代號：7815)

董事長	陳儒宏
總經理	李宗潤
資本額	新台幣329,756,310元
輔導推薦證券商	兆豐證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	兆豐證券股份有限公司 梁奕凱 (03)666-2898 分機205
註冊地國	非外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	非外國發行人，故不適用

輔導推薦證券商認購新特系統股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	兆豐證券股份有限公司	中國信託綜合證券股份有限公司

認購日期	114年1月9日									
認購股數 (股)	890,000股	100,000股								
認購占擬 櫃檯買賣 股份總數 之比率	2.70%	0.30%								
認購價格	每股新台幣150元									
認購價格 之訂定 依據及方 式	<p>一、認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式：本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法(本益比法)以推算合理之認購價格，作為新特系統股份有限公司(以下簡稱新特或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考認購價格訂定依據。再參酌該公司所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。</p> <p>二、認購價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較，目前股票價值評估方法眾多，各方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前常用之股票評價方法主要包括：</p> <p>(1)市價法：本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)或股價淨值比法(Price Book value ratio, P/B ratio)，均透過已公開的資訊與整體市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業之價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整。</p> <p>(2)成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。</p> <p>(3)現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值評定之基礎。</p> <p>以上股票評價方法：成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或產業成熟但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。</p> <p>三、發行人與已上市櫃同業之本益比之比較情形</p> <p>該公司主要業務為驅動晶片探針介面卡、模組及技術服務之研發、設計、生產、銷售，為半導體產業下游之專業半導體測試介面廠，主要產品為：顯示器驅動晶片探針卡，應用於顯示器驅動 IC 測試製成檢驗。經參酌與該公司目前之產品服務或營運模式較相似之上市櫃公司有穎崴(6515)、雍智(6683)、旺矽(6223)，故選擇前開公司為比較之同業。</p> <table border="1" data-bbox="384 1767 1422 1989"> <thead> <tr> <th>公司別</th> <th>主要營收項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>穎 崴(6515)</td> <td>測試治具、接觸元件、探針卡及其他</td> </tr> <tr> <td>雍 智(6683)</td> <td>半導體晶圓測試載板</td> </tr> <tr> <td>旺 矽(6223)</td> <td>晶圓探針卡銷售及維修、晶圓測試與分選設備、光電半導體晶圓與元件之測試、分選與光學檢查設備</td> </tr> </tbody> </table> <p>資料來源：各公司112年度年報</p>		公司別	主要營收項目	穎 崴(6515)	測試治具、接觸元件、探針卡及其他	雍 智(6683)	半導體晶圓測試載板	旺 矽(6223)	晶圓探針卡銷售及維修、晶圓測試與分選設備、光電半導體晶圓與元件之測試、分選與光學檢查設備
公司別	主要營收項目									
穎 崴(6515)	測試治具、接觸元件、探針卡及其他									
雍 智(6683)	半導體晶圓測試載板									
旺 矽(6223)	晶圓探針卡銷售及維修、晶圓測試與分選設備、光電半導體晶圓與元件之測試、分選與光學檢查設備									

採樣同業	本益比			
	113/9	113/10	113/11	平均
穎 歲(6515)	71.82	71.79	61.89	68.50
雍 智(6683)	24.29	23.59	22.54	23.47
旺 矽(6223)	44.25	46.86	41.90	44.33
上市半導體類股	26.07	27.74	24.28	26.03
上櫃半導體類股	27.57	26.71	26.87	27.05

資料來源：證交所及櫃檯買賣中心

該公司之採樣同業及上市櫃半導體類股於113年9至11月之平均本益比約介於23.47~68.50倍之間，由於同業穎歲之本益比高於另2家同業較多，擬將其排除後之平均本益比區間為23.47~44.33倍，依據該公司112年度及113年上半年度經會計師查核或核閱之財務報告，設算該公司最近四季(112年第三季至113年第二季)之稅後淨利為171,737千元，以該公司目前股本32,975千股設算之最近四季每股稅後盈餘為5.21元，並考量興櫃市場之流動性風險貼水而採八折計算，其每股合理價格區間為97.82元~184.77元，議定推薦證券商股票認購價格為150元，介於每股合理價格區間內，故議定之認購價格尚屬合理。

四、推薦證券商就其與發行人所共同議定認購價格合理性之評估意見。

綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定係參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並考量該公司之所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之興櫃每股認購價格，尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

新特系統股份有限公司於103年2月成立，為專業的半導體測試介面廠。主要致力於驅動晶片探針介面卡、模組及技術服務之研發、設計、生產、銷售；新特生產的產品係於傳統型探針卡的基礎上，達到以較低階的測試機來測試更高階之顯示器驅動晶片，不僅能幫助 IC 設計公司降低產品的測試成本，也能提高封裝測試廠現有機台之稼動率。

新特以紮實的研發能力、專業的技術團隊及具有產業經驗的客服團隊為後盾，提供客戶高品質的產品與及時的服務，以達成客戶滿意為目標，創造企業最大價值。

二、歷史沿革

年 度	項 目
民國 103年	民國103年2月正式設立登記完成，實收資本額為10,000仟元。
	民國103年7月辦理現金增資20,000仟元，實收資本額30,000仟元。
民國 104年	民國104年1月辦理現金增資35,000仟元，實收資本額65,000仟元。
	民國104年6月辦理現金增資35,000仟元，實收資本額100,000仟元。
	民國104年12月發行員工認股權憑證2,400股。
	推出應用於 mipi DPHY DDI 之高速訊號倍頻器探針卡。 高速傳輸1GBps 探針卡量產。
民國 105年	民國105年2月辦理現金增資60,000仟元，實收資本額160,000仟元。
	3000針之高針數探針卡量產。

修訂日期：113年7月

	推出應用於 miniLVDS DDI 之高速訊號倍頻器探針卡。
	高速傳輸2GBps 探針卡量產。
民國 106年	通過 ISO 9001:2015品質認證。
	車載顯示驅動晶片探針卡量產。
	開發具類比數位轉換器擴充模組之探針介面卡。
	TDDI 顯示觸控驅動晶片探針卡量產。
民國 107年	推出內建高速訊號發接受器之 LCD TCON 測試載板。
民國 108年	民國108年4月因廠房擴充承租新竹縣竹北市台元一街5號6樓之6辦公室。
	民國108年8月辦理現金增資15,000仟元，實收資本額187,390仟元。
	民國108年12月發行員工認股權憑證2,000股。
	高速傳輸4GBps 探針卡量產。
	推出 mipi DPHY 高速訊號產生器測試模組。
民國 109年	推出 P2P 高速訊號產生器測試模組。
	推出高頻探針 GS 結構設計。
	完成微間距探針頭開發/製作。
	完成車用高耐電流探針開發。
	AMOLED 顯示驅動晶片探針卡量產。
	完成探針特殊鍍膜技術開發。
民國 110年	民國110年2月辦理現金增資20,000仟元，實收資本額221,920仟元。
	民國110年7月股息及紅利轉增資13,315仟元；員工酬勞轉增資13,267仟元，實收資本額248,502仟元。
	民國110年11月因廠房擴充承租新竹縣竹北市台元一街5號6樓之7辦公室。
	開發 mipi CPHY 高速訊號產生器測試模組。
	開發探針卡超低漏電流檢測機。
	完成微間距(Pitch<80um)垂直式探針卡開發計畫。
	完成開發探針自動量測/檢驗系統。
	完成開發探針 Auto Line up 整列設備。
	5000針之高針數探針卡量產。
	車用控制 IC 垂直式針卡開發計畫。
民國 111年	民國111年8月股息及紅利轉增資17,395仟元；員工酬勞轉增資17,791仟元，實收資本額283,689仟元。
	開發 LVDS 與 mipi DPHY 高速訊號產生器測試模組。
	民國111年1月因廠房擴充取得新竹縣竹北市惟馨街辦公室。
	完成微間距(Pitch50um)空間轉換器開發。
	完成高頻訊號量測系統微機電探針(MEMS Probe)建置。
	完成 AI PC 需求高速 IO 晶片垂直探針卡開發計畫。
	PCIe 4.0傳輸協定控制 IC 晶圓測試用垂直探針卡開發計畫。
	完成精密磨針設備開發。

	針尖微加工成形技術開發。
民國 112年	民國112年2月因廠房取得南科土地。
	民國112年7月股息及紅利轉增資5,674仟元；員工酬勞轉增資4,631仟元，實收資本額293,994仟元。
	完成主動式負載測試電路開發。
	開發第二代 P2P 高速訊號產生器測試模組。
	探針卡 III 漏電流檢測機。
民國 113年	民國113年4月因廠房擴充承租新竹縣竹北市台元一街5號13樓之1辦公室。
	民國113年8月股息及紅利轉增資5,880仟元；員工酬勞轉增資4,883仟元，實收資本額304,756仟元。
	民國113年11月辦理現金增資375,000仟元，實收資本額32,976仟元。

三、經營理念

專注於測試介面的解決方案。對於客戶在測試工程尤其高頻高同測數及成本的需求，提供高品質及創新的主動電路協助平台選擇的多樣性，讓客戶在品質跟成本上獲得最大優勢。

四、未來展望

1.短期業務發展計畫

- a. 持續擴大 LCD driver cpc 產能及市佔。
- b. 強化所有 LCD 車載的深耕，由於 TDDI 的加入，目前所需 pin count 將為現有需求再增加1/3，新特將持續擴大車載應用領域之合作。
- c. 持續致力於開發具潛力之新客戶，拓展更多探針卡客戶群，尤以大陸地區，在 IC 測試的探針卡需求成長速度飛快，在全球疫情趙趙緩後，已大幅增加。
- d. 提升公司組裝與維修服務能量，為全球客戶提供探針卡統包服務，提高海外客戶。

2.長期業務發展計畫

- a. 垂直探針卡開發案(Mems)，目前已經進入驗證階段。
- b. 強化技術能力，進入 AI 未來技術發展趨勢，積極參與台灣國際半導體展、海外相關半導體展覽，以及探針卡相關研討會，定期發表新產品與研發成果，強化全球技術行銷能力，讓公司自有技術為全球客戶廣為知曉。
- c. 完善各應用領域所需的針款:掌握半導體具質整合趨勢，並持續精進 High Pin Count(高接腳數)、Fine Pitch(細間距)、High Current (高電流)、High Speed(高速)等探針技術，拓展應用領域。
- d. 持續優化數位轉型技術及服務:透過數位轉型，在公司經營管理、技術與產品研發、內部流程、客戶服務等各環節，藉由全面數位化並導入人工智慧整合與重塑資訊流，打造領先業界的高效率團隊，建立更高的產業門檻，導入智慧製造，產線智慧優化，使其有穩定之產能與品質。
- e. 持續擴充廠房、生產設備、公司員工，增加產能以因應客戶端逐步增加的訂單需求。

TOP ^

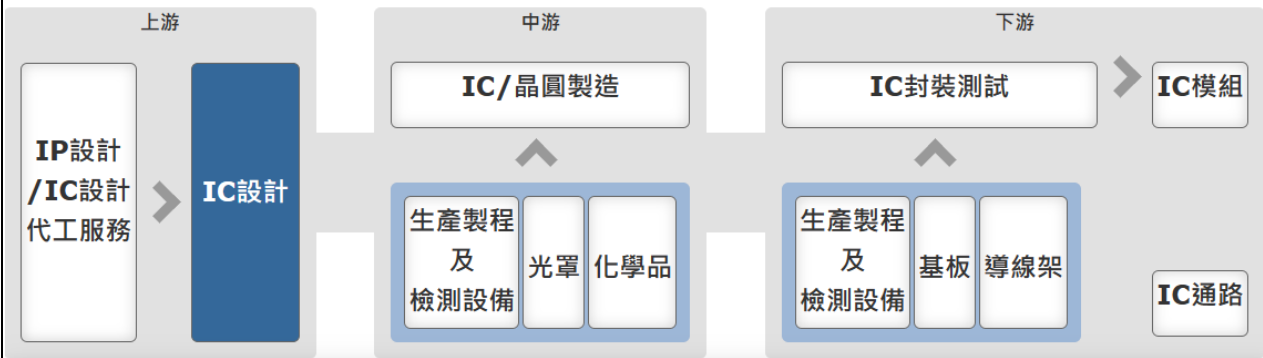
主要業務項目：

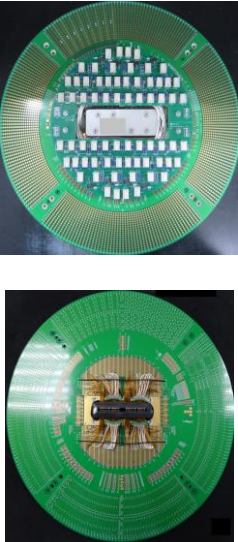
新特主要業務為驅動晶片探針介面卡、模組及技術服務之研發、設計、生產、銷售，為半導體產業下游之專業半導體測試介面廠。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

半導體產業鏈上游為 IP 設計及 IC 設計業，中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等產業，下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件、IC 模組、IC 通路等業。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，IC 設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠或 IDM 廠製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為最終產品。

IC 測試則可分為兩階段，一是進入封裝之前的晶圓測試，主要測試電性。另一則為 IC 成品測試，主要在測試 IC 功能、電性與散熱是否正常，以確保品質。台灣 IC 封裝與測試產業，穩坐全球之冠，隨著 IoT 應用興起，台灣 IC 封裝與測試業者持續布局高階封裝與異質整合技術，拉大與競爭業者之差距。



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
顯示器 驅動晶片 探針卡		顯示器驅動晶片在晶圓生產完成未切割成單一晶粒前都需要經過 CP 測試，探針卡是該測試階段的重要測試介面及平臺，透過探針卡與測試平臺可以測試晶圓品質，可避免不良品的封裝成本，是積體電路製造中對於製造成本影響頗巨的重要技術與介面。	604,035	99.70
其他		維修收入	1,794	0.30
合計			605,829	100.00

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年	109年	110年	111年	112年	113年截至11月份止 (自結數)(註2)
營業收入		281,397	477,784	701,388	580,654	605,829	779,756
營業毛利		114,751	211,979	344,819	270,580	305,382	400,951
毛利率(%)		40.78	44.37	49.16	46.60	50.41	51.42
營業損益		48,574	128,297	219,325	113,429	137,993	185,969
營業外收入		3,215	3,503	2,750	8,118	6,297	9,250
營業外支出		(1,701)	(2,040)	(600)	(509)	(3,932)	(4,623)
稅前損益		50,088	129,760	221,475	121,038	140,358	190,596
稅後損益		50,088	103,903	175,711	97,199	113,486	152,448
每股盈餘(元)		2.8	5.27	7.33	3.40	3.87	4.98
發放	現金股利(元)	0.5	0.8	0.8	1.0	—	—
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	—	—	—	—	—	—
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	0.60	0.70	0.2	0.2	—	—

註1：上列各年度財務資料經會計師查核簽證。該公司自108年度起適用國際財務報導準則並編製財務報表。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	108年	109年	110年	111年	112年
流動資產		236,124	410,575	722,020	704,299	799,887
基金及長期投資		—	—	—	—	—
固定資產		46,754	66,737	107,065	176,282	199,538
無形資產		—	3,147	6,822	4,922	2,853
其他資產		43,298	28,045	30,997	89,496	182,743
資產總額		326,176	508,504	866,904	974,999	1,185,021
流動負債	分配前	112,148	189,930	223,646	219,171	223,900
	分配後	112,148	201,026	243,526	241,866	253,299
長期負債		—	—	—	—	—
其他負債		28,812	20,474	20,142	9,053	109,894
負債總額	分配前	140,960	210,404	243,788	228,224	333,794
	分配後	140,960	221,500	263,668	250,919	363,193
股本		193,770	201,920	248,502	283,689	293,994
資本公積		4,626	5,457	132,591	161,140	170,170
保留盈餘	分配前	(13,180)	90,723	242,023	301,946	387,063
	分配後	(13,180)	79,627	222,143	279,251	357,664

修訂日期：113年7月

長期股權投資		—	—	—	—	—
未實現跌價損失		—	—	—	—	—
累積換算調整數		—	—	—	—	—
股東權益	分配前	185,216	298,100	623,116	746,775	851,227
總額	分配後	185,216	287,004	603,236	724,080	821,828

註：上列各年度財務資料經會計師查核簽證。該公司自108年度起適用國際財務報導準則並編製財務報表。

TOP ^

最近三年度財務比率					
項目		年度	110年	111年	112年
財務比率	毛利率(%)		49.16	46.60	50.41
	流動比率(%)		322.84	321.34	357.25
	應收帳款天數(天)		89.46	101.38	92.87
	存貨週轉天數(天)		175.48	229.56	250.00
	負債比率(%)		28.12	23.40	28.16

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)